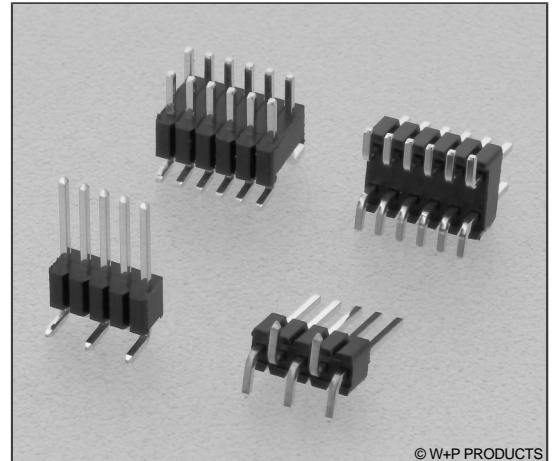


7060 / 7070

SMT-Stiftheisen RM 1,27x2,54mm, stehend, 1-/2-reihig SMT Pin Headers, 1.27x2.54mm Pitch, Vertical, Single/Double Row

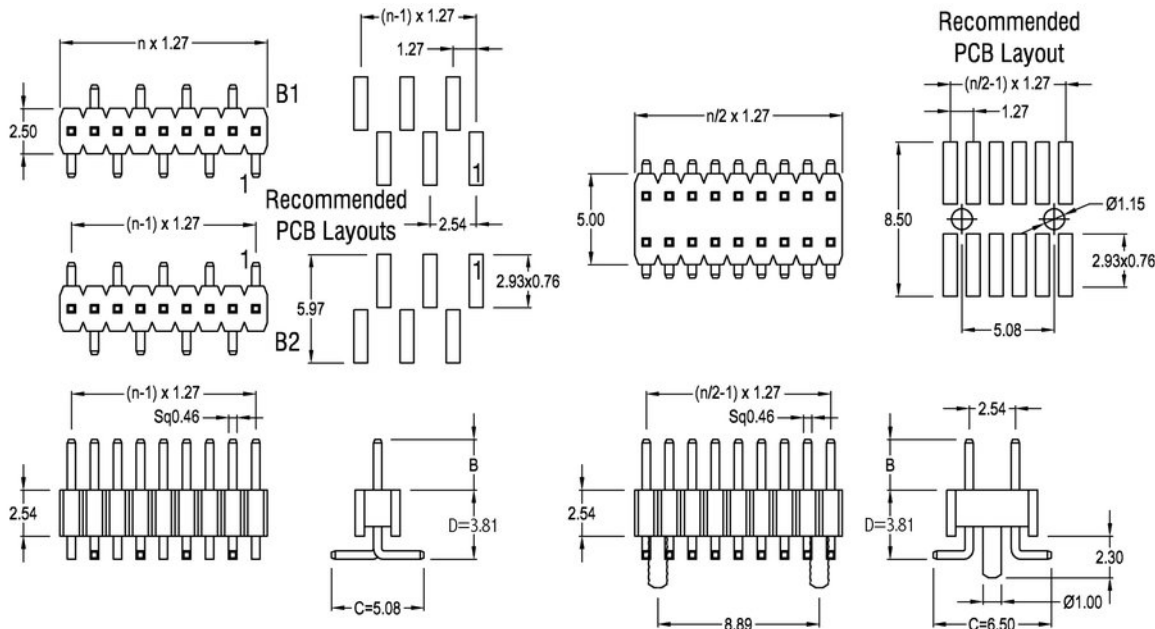
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,46mm, Kupferlegierung <i>0.46mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{AC}
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V _{AC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
7110



Series	Contacts*	Layout*	Dimensions*	Plating*	Packaging*
7060	040 003-040 Einreihig Single row	11 11 Einreihig B1 Single row B1 12 Einreihig B2 Single row B2	10 10 B=2,80 C=5,08mm 20 B=6,00 C=5,08mm 99 Kundenspezifisch Customer-specific	00 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	PPST ST PPST PPTR (Option)
Series	Contacts*	Dimensions*	Plating*	Loc. Peg*	Packing*
7070	020 004-100 Zweireihig Double row	10 10 B=2,80 C=6,50mm 20 B=6,00 C=6,50mm 99 Kundenspezifisch Customer-specific Bei einem D-Maß über 4mm keine Pos.hilfen No locating peg at dim. D larger than 4mm	00 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	10 00 Ohne Pos.hilfe W/o loc.peg 10 Mit Pos.hilfe With loc.peg	PPST ST PPST PPTR (Option)

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

